



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 103222351 A

(43) 申请公布日 2013. 07. 24

(21) 申请号 201180053540. 0

(51) Int. Cl.

(22) 申请日 2011. 10. 25

H05K 3/42 (2006. 01)

(85) PCT申请进入国家阶段日
2013. 05. 07

(86) PCT申请的申请数据
PCT/CN2011/081235 2011. 10. 25

(87) PCT申请的公布数据
W02013/059985 ZH 2013. 05. 02

(71) 申请人 建业(惠州) 电路版有限公司
地址 中国香港新界沙田白石角香港科学园
科技大道西 8 号尚湖楼 6 字楼 607 室

(72) 发明人 黄锡金

(74) 专利代理机构 广州华进联合专利商标代理
有限公司 44224

代理人 吴平

(54) 发明名称

印刷电路板孔金属化的方法

(57) 摘要

提供一种印刷电路板孔金属化的方法。将钻孔后的印刷电路板依此进行如下步骤处理：磨板处理、第一次水洗、膨松处理、第二次水洗、除胶渣、第三次水洗、中和处理、第四次水洗、干燥、第一次微蚀处理、第五次水洗、除油处理、第六次水洗、第一次黑孔化处理、干燥、整孔处理、第七次水洗、第二次黑孔化处理、干燥、第二次微蚀处理、第八次水洗、磨板处理、第九次水洗、抗氧化处理、第十次水洗、干燥及电镀铜处理。黑孔工艺基材上的铜与电镀铜连接可靠，不存在铜连接分层问题，可靠性好，且黑孔工艺在基材表面不会有杂质，连接质量较好。此外，黑孔工艺没有用到甲酸、重金属，对环境基本无污染。

